

# 点胶式液态导热垫片 XK-S30LV®

## Thermal Conductivity Silicone Gel XK-S30LV

特性：

- 1:1混合 ( 流淌式 )
- 1:1mix(no cure by-product)
- 低应力应用
- low stress applications
- 操作方便
- Easy to Use
- 加热加速反应
- Hear Fast Cure



- 應用：
- 汽車電子
  - Automotive electronics
  - 通訊設施
  - Telecommunications
  - 電腦及周邊產品
  - Computer & peripherals
  - 導熱，減震
  - Thermally conductive vibration dampening
  - 熱源與散熱器間應用
  - Between any heat-generating semiconductor and a heat sink

	XK-S30LV	METHOD	UNIT
颜色 Color / Part A	Blue	Visual	
颜色 Color / Part B	White	Visual	
特征 Features	Soft GEL	-	-
密度 Density	3.1	ASTM D792	g/cm3

### 固化前性能 Before Cured Property

A:B	1:1	-	-
混合粘度 Mixed Viscosity (20rpm)	60,000	ASTM D2196	Cps
保质期 Shelf Life @ 25°C	6 month		

### 固化后性能 After Cured Property

颜色 Color	Blue	Visual	-
固化时间 Cure Schedule 1	24hr/25°C		
固化时间 Cure Schedule 2	100min/80°C		
固化时间 Cure Schedule 3	10min/100°C		
操作时间 Pot life	30 min/25°C		
硬度 Hardness	Shore 00 = 80	ASTM D2240	
	AskerC = 35	JIS K7312	
抗张强度 Tensile Strength.	>0.2	ASTM D412	Mpa
伸长率 Elongation	80	ASTM D412	%
使用温度 Continuous Use Temp	-60~200		°C

### 电性能 Electrical Property

击穿电压 Dielectric strength	>10	ASTM D149	KV/mm
体积电阻 Volume resistivity	>10 <sup>13</sup>	ASTM D257	Ohm-cm
介电常数 Dielectric Constant	8	ASTM D150	(1KHz)
阻燃性 Flame Rating	V-0	UL94	

### 热性能 Thermal Property

导热系数 Thermal Conductivity	3.5	ASTM D5470	W/m*K
导热系数 Thermal Conductivity	3.0	Hotdisk	W/m*K
比热容 Heat Capacity	1	ASTM E1269	J/g-K